

Technisches Datenblatt

Vakuum-Metallisierung

EMV-Abschirmung

Cu/NiCr-Bedampfung



<u>Verfahren:</u>	Vakuum-Metallisierung nach dem PVD-Verfahren (Physical Vapor Deposition).
<u>EU-Richtlinien:</u>	RoHS-Konform (2011/65/EU + 2015/863) WEEE-Recyclingfähig (2012/19/EU) REACH-Konform ((EG) 1907/2006) + 2015/830/EU)
<u>Einsatzmaterial:</u>	Cu/NiCr - Kupfer Cu 1,5 µm - 3 µm - Nickel-Chrom NiCr 0,15µm Dreiwertiges Chrom Cr (III)
<u>Einsatzmöglichkeit:</u>	Auf fast allen Kunststoffen, Metallen und Glas. (weitere Materialien auf Anfrage).
<u>Schichtdicke:</u>	1,5 µm bis 3,0 µm
<u>Dämpfung:</u>	60 dB – 80 dB (z.B. bei Kunststoffen von 30 MHz bis 1 GHz)
<u>Dichte:</u>	8,92 g / cm ³
<u>Elektr. Leitfähigkeit:</u>	59,1 x 10 ⁶ S / m
<u>Schmelzpunkt:</u>	1084 ° C
<u>Wärmeleitfähigkeit:</u>	(λ) : 400 W / mK